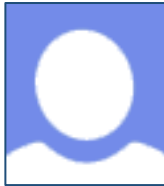


10月31日(金) 15:15-17:30

セッションチェアマン： 不破 保博(元ローム株)・森川 泰宏(株アルバック)

◆ GL コアの動向(仮題)



大日本印刷株式会社

藤本 興治

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

◆ 先端半導体パッケージサイズ拡大におけるモールドイング技術の動向



TOWA 株式会社
市場開発部 営業技術課
シニアリーダー
寺本 翔太

[講演要旨]

近年では、生成 AI や HPC 向けに 2.5D チップレット集積や、3D 実装といった先端半導体において、製造コスト拡大や工程の複雑化が進んできている。こうした中、後工程であるパッケージング技術が注目されている。特に 2.5D や 3D 実装を伴うチップレット構造では、実装・封止が性能や信頼性に直結する。本講演では、次世代 PKG に対応するコンプレッション成形技術の最新動向について紹介する。

[講演者プロフィール]

2008 年 3 月、近畿大学卒業(学士号 電気電子工学専攻)。

2008 年 4 月、TOWA 株式会社に入社、モールド技術部に所属し、モールド金型の設計を担当。

2015 年 4 月から市場開発部 営業技術課に所属して、先端半導体製品のモールド評価に従事しており、現在に至ります。

◆ 先端半導体パッケージ向けガラス基板用 TGV 用シード層および硫酸銅めっきの開発動向



奥野製薬工業株式会社
総合技術研究部
基板半導体領域
領域長
吉川 純二

[講演要旨]

大型化する半導体パッケージ基板のコア材に寸法安定性の高いガラスを使用する検討が盛んになっている。ただし、厚板ガラス材のスルーホール形成にスパッタシードでは限界があるため、オールウェットプロセスでの実現が求められている。本講演では、酸化亜鉛を密着層とした新しい湿式シード形成プロセスを中心に、スルーホールフィリングによる高信頼性表面処理プロセスを紹介する。

[講演者プロフィール]

2000 年関西大学工学部卒業

奥野製薬工業株式会社 総合技術研究部に入社後、樹脂めっき用途および電子部品用途の薬品開発に 20 年従事。

半導体パッケージのサブストレート基板およびインターポーザ基板に対する配線品質やビアフィリング関係の機能性硫酸銅めっき薬品を主に開発担当し、現在に至る。

※本講演に興味を持たれた方は、こちらの講演もご覧になっています。

【D-1】技術・マーケットトレンド

【D-2】光電融合